

Silspher HP23 硅球粉

产品简介

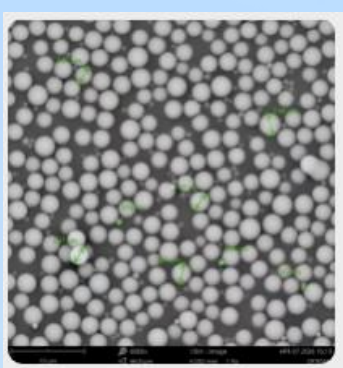
Silspher HP23, 化学合成法制备的球形二氧化硅微粉, 联锆化学精准的粒径大小卡控技术, 使得粒径大小均一、球形度高、球表面光滑, 亚微米粒径。非中空密实的球体, 填充量更高。电导率低和较低的 DF 值、分散性超强不易团聚。广泛应用于半导体封装材料, PCB 基板、IC 载板等。

产品特点

- (1) 粒径大小均一、粒度分布窄。
- (2) 密实的球形结构、球表面光滑, 较低热膨胀系数。
- (3) 显著提高基板的耐机械冲击性能和耐裂纹性能。
- (4) 二氧化硅纯度高, 低介电常数和低介电损耗, 具有出色绝缘效果,
- (5) 非常优越的树脂助流动性能。

技术指标

指标性能	特征值	指标性能	特征值
形貌	球形	外观	白色粉末
粒径 D50 (um)	3±0.3	比表 (m ² /g)	5.8
D100 (um)	6.0	表面改性	可定制
干燥失重 (%)	≤0.5		



应用领域

- (6) 半导体封装。
- (7) 电子密封胶。
- (8) 智能手表、智能驾驶及 5G 通信。

推荐用量

总配方量 30%~80%, 由于不同的配方和条件, 建议用户在使用前进行试验, 确定最佳的添加量。

储存条件

- (1) 常规 20kg/桶, 也可根据客户要求做个性化定制。
- (2) 应当常温干燥, 密封储存, 防潮防湿。

江西联锆化学有限公司

了解更多产品请登录网站: www.kingchemin.com/

服务热线: 销售 18079779889 胡生

技术 18970789158 徐工